

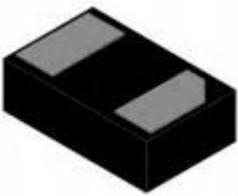


RSUN TECH

文件名称：RSUN2C121V封装资料

变更履历

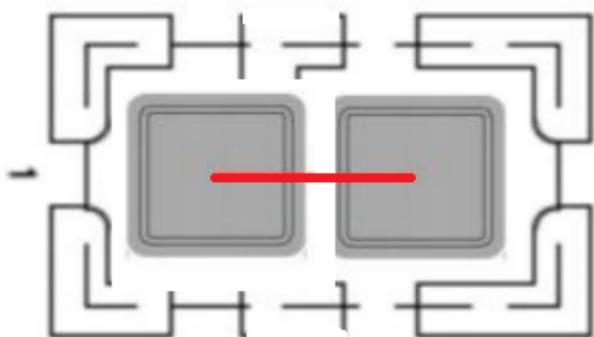
| 版本号 | 变更内容 | 变更人 | 审核人 | 日期 |
|------|------|-----|-----|------------|
| V1.0 | 初版 | 罗正军 | 罗正军 | 2025.05.30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------|---|----------------|--|
| 文件名称 | RSUN2C121V封装资料 | 发布日期 | 2025.05.30 | |
| | | 文件编号 | RSUN-Y056-0002 | |
| 一、封装形式 : DFN1006-2L | | 印 字 单位 : MM | | |
|  | |  | | |
| 二、晶圆说明 | | | | |
| 晶圆名称 | E022017A | 晶圆尺寸 | 6寸 | |
| 焊盘尺寸 | 160um* 160um | 划片道 | 50um | |
| 芯粒尺寸 (含划片道) | 220um* 220um | 晶圆厚度 | 120um± 12um | |
| 焊盘材料 | Ag | 背面金属 | Ag | |

三、胶水、焊线方式说明

1. 两芯片需用导电胶与框架的两边基岛连接。
2. 使用1mil 钴铜线1根，总焊线数目为1根/DIE
3. 焊线前必须确认芯片上的焊盘与封装外引脚的功能端子一一对应。

4. 焊线图示





| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 文件名称 | RSUN2C121V封装资料 | 发布日期 | 2023.05.30 |
| | | 文件编号 | RSUN-Y056-0002 |

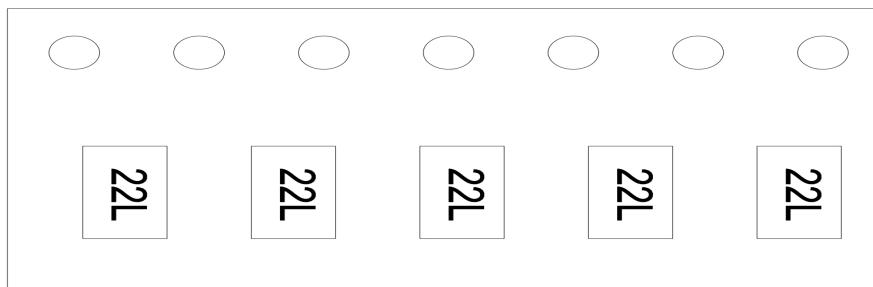
四、技术要求（测试规范）

功能测试项目 (V1) 前增加 O/S 测试，用于筛选封装不良

| 参数名称 | 符号 | 规范值 | 测试 条件 |
|------|-----------------|--------|----------------------|
| 击穿电压 | V _{BR} | 15V~18 | I _R =1mA |
| 漏电流 | I _R | ≤0.2uA | V _R =±15V |

五、编带方向

编带(10K/盘前后空格前100格，后100格)，编带颜色黑色，蓝色塑料盘，载带定位孔位于塑料盘镂空一面。



六、标签格式（以实际订单为准）

标签尺寸：48*80mm



七、包装要求：编带及包装要求具体参考《RSUN---包装规范A》

| | | | | |
|-----|----|----|------|--------------|
| 编制 | 审核 | 品质 | 客户签字 | 文件发行单位: |
| 罗正军 | | | | 深圳市亚尔讯科技有限公司 |